

第四章 半导体器件原理

semiconductor device

4.1 pn结特性概述

4.1.1 平衡pn结 the pn junction in thermal equilibrium

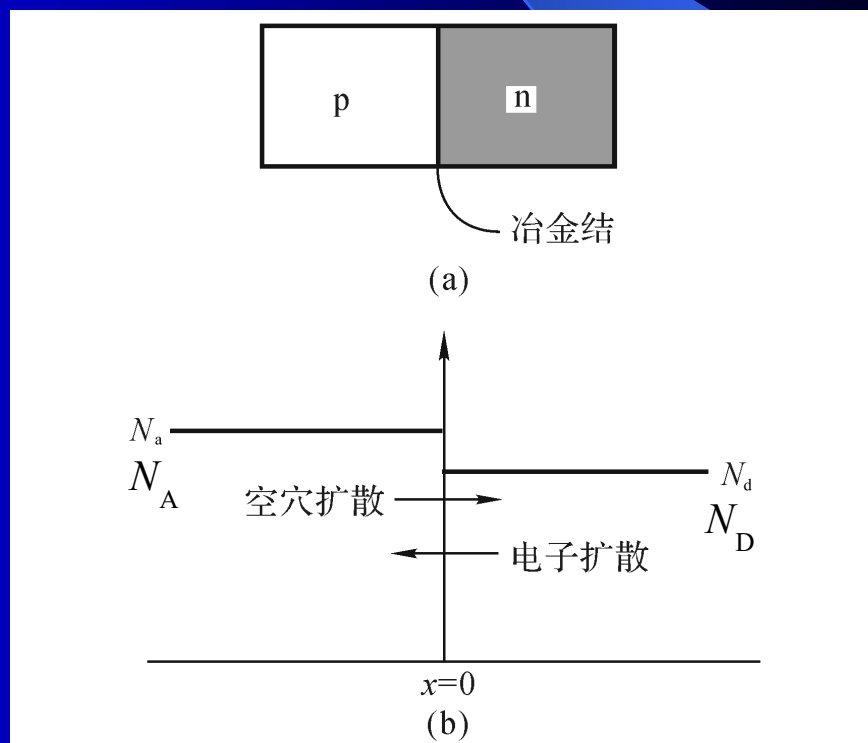
pn结：由单晶半导体上相邻两个区（p型区和n型区）的交界面附近的过渡区构成

n区掺施主杂质，浓度 N_D ，
提供导带电子

p区掺受主杂质，浓度 N_A ，
提供价带空穴

空穴从p区向n区扩散

电子从n区向p区扩散



- 同质结：以两种相同的半导体单晶材料为基础
- 异质结：以两种不同的半导体单晶材料为基础
- pn结：在导电类型相反的半导体单晶材料交界处形成
- 高低结：在导电类型相同的半导体单晶材料交界处形成

n区：（导带）电子多、（价带）空穴少，
载流子带负电
施主离子带正电



电中性

p区：（价带）空穴多、（导带）电子少，
载流子带正电
受主离子带负电



电中性

(空穴多、电子少) **p区** **n区** (电子多、空穴少)

结合

p区 **n区**

p区 $-$ $+$ **n区**

载流子
浓度差

空穴从p区向n区扩散

电子从n区向p区扩散

结p区侧聚集负离子(电离受主)

结n区侧聚集正离子(电离施主)

负空间电荷区

正空间电荷区

阻止进一步扩散，形成并增强相反方向的漂移运动

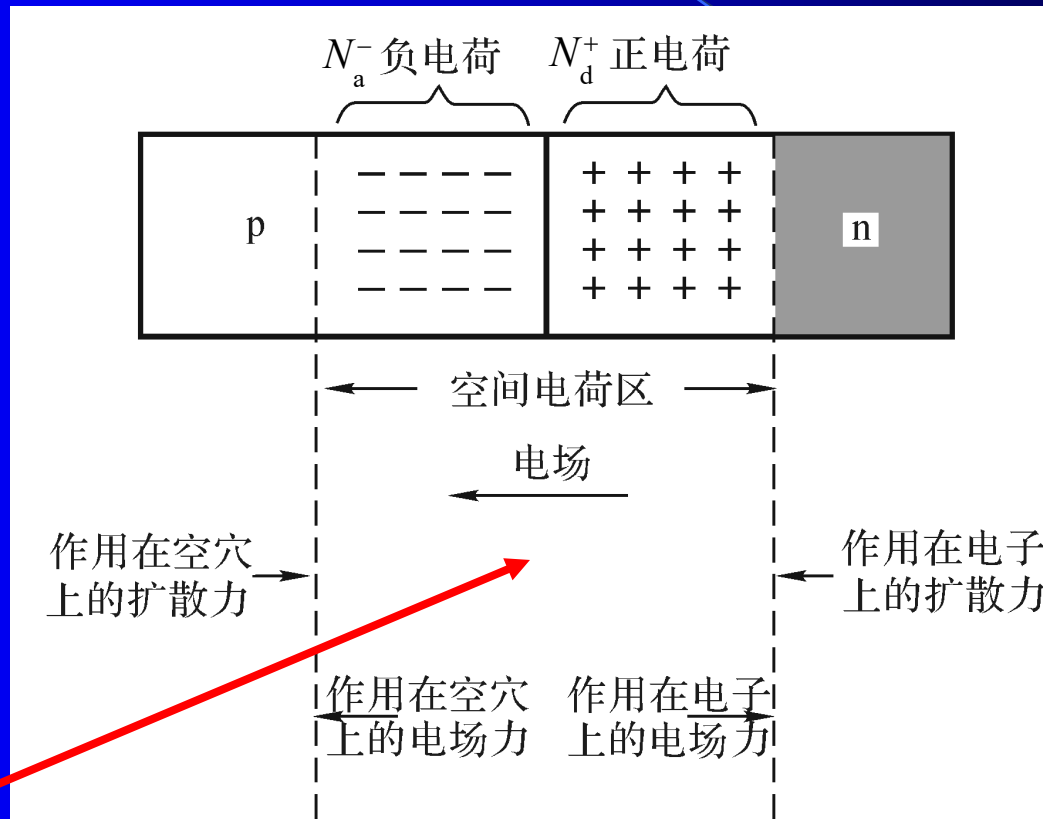
动态平衡

扩散与漂移的动态平衡



空间电荷区导致内建电场built-in field

热平衡、无外场不产生净电流



空间电荷区space charge region的正负空间电荷分离，内建电场，“耗尽”了可动的载流子，空间电荷区也称耗尽区depletion region

同质pn结能带:

本征半导体

E_C —————

E_{Fi} - - - - -

E_V —————

p型半导体

E_C —————

E_{Fp} - - - - -

E_V —————

n型半导体

E_C —————

E_{Fn} - - - - -

E_V —————

电子从高 E_F 区流向低 E_F 区, E_F 下降
(从n区向p区运动)

空穴从低 E_F 区流向高 E_F 区, E_F 上升
(从p区向n区运动)

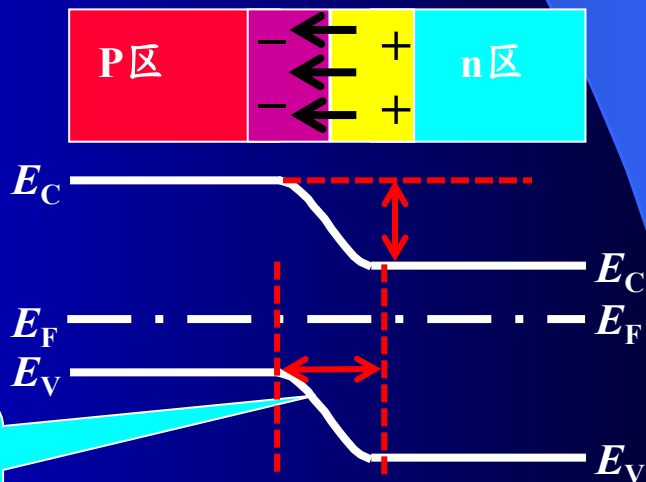
如何求解空间电荷区的宽度和势垒高度

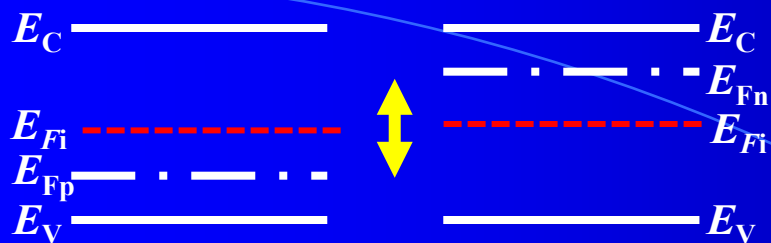
横坐标为
空间位置

结合

热平衡,
统一的 E_F

pn结





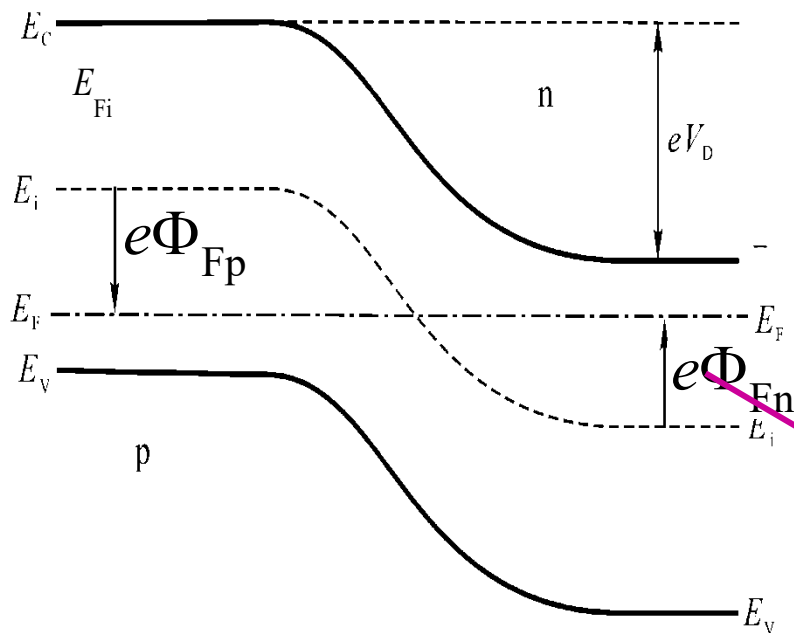
$$eV_D = e|\Phi_{Fn}| + e|\Phi_{Fp}|$$

$$e\Phi_{Fn} = E_{Fi}(n[\bar{x}]) - E_F$$

$$e\Phi_{Fp} = E_{Fi}(p[\bar{x}]) - E_F$$

空间位置的函数

n区导带电子浓度:



施主浓度donor concentration

$$n = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F}{k_B T}\right)$$

本征半导体

$$n_i = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_{Fi}}{k_B T}\right)$$

完全电离

$$n = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_{Fi}}{k_B T}\right)$$

$$n \approx N_D$$

$$\Phi_{Fn} = \frac{E_{Fi} - E_F}{e} \approx -\frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right)$$

$$p = N_V \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{k_B T}\right)$$

本征
半导体

$$p_i = N_V \exp\left(-\frac{E_{Fi} - E_V}{k_B T}\right) = n_i$$

完全
电离

$$p = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_F}{k_B T}\right)$$

$$p \approx N_A$$

$$\Phi_{Fp} = \frac{E_{Fi} - E_F}{e} \approx \frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)$$

n区导带电子电位:

$$\Phi_{Fn} \approx -\frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right)$$

p区价带空穴电位:

$$\Phi_{Fp} \approx \frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)$$

接触电位差:

$$\begin{aligned} V_D &= |\Phi_{Fn}| + |\Phi_{Fp}| \\ &= \frac{k_B T}{e} \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) \\ &= V_T \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) \end{aligned}$$

$$V_T = \frac{k_B T}{e} \quad (\text{热电压})$$

同质pn结

受主浓度 acceptor concentration

室温热电压 thermal voltage:
 $V_T = 0.026 \text{ V}$

同质突变pn结

• 空间电荷区用泊松（Poisson）方程

$$\frac{d^2\Phi(x)}{dx^2} = -\frac{dE(x)}{dx} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon_r \epsilon_0}$$

$$P \text{区} \rho(x) = -eN_A \quad \downarrow \quad N \text{区} \rho(x) = eN_D$$

$$E(x) = \int \frac{\rho(x)}{\epsilon_r \epsilon_0} dx$$

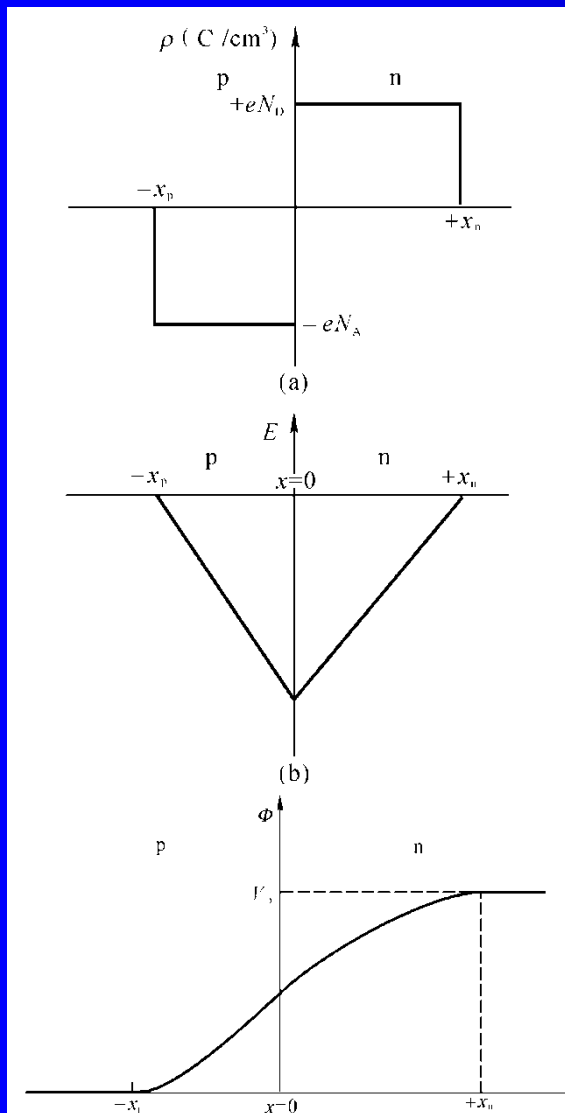
$$P \text{区} \quad E(x) = -\frac{eN_A}{\epsilon_r \epsilon_0} (x + x_p)$$

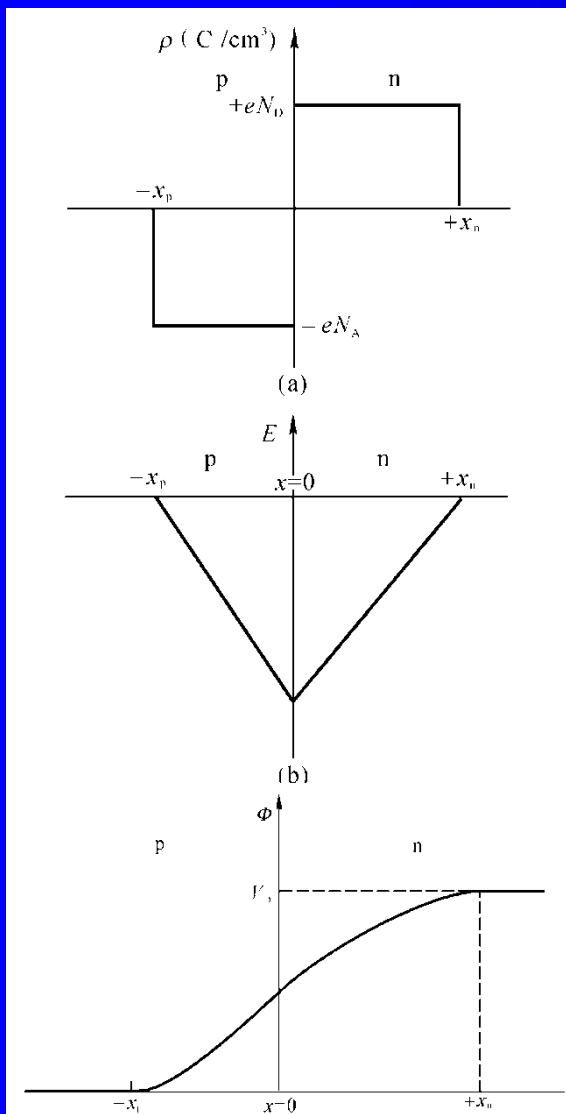
$$N \text{区} \quad E(x) = -\frac{eN_D}{\epsilon_r \epsilon_0} (x_n - x)$$

电场在0位置连续

$$N_A x_p = N_D x_n$$

- 电中性条件;
- 电场与位置呈线性关系;
- 最大电场在结平面处。





$$\text{P区} \quad E(x) = -\frac{eN_A}{\epsilon_r \epsilon_0} (x + x_p)$$

$$\text{N区} \quad E(x) = -\frac{eN_D}{\epsilon_r \epsilon_0} (x_n - x)$$

$$\Phi(x) = -\int E(x) dx$$

假设 $-x_p$ 位置电位为零

$$\text{P区} \quad \Phi(x) = \frac{eN_A}{2\epsilon_r \epsilon_0} (x + x_p)^2$$

$$\text{N区} \quad \Phi(x) = \frac{eN_D}{\epsilon_r \epsilon_0} (x_n x - \frac{x^2}{2}) + \frac{eN_A}{2\epsilon_r \epsilon_0} x_p^2$$

位能在空间电荷区随位置呈平方律变化

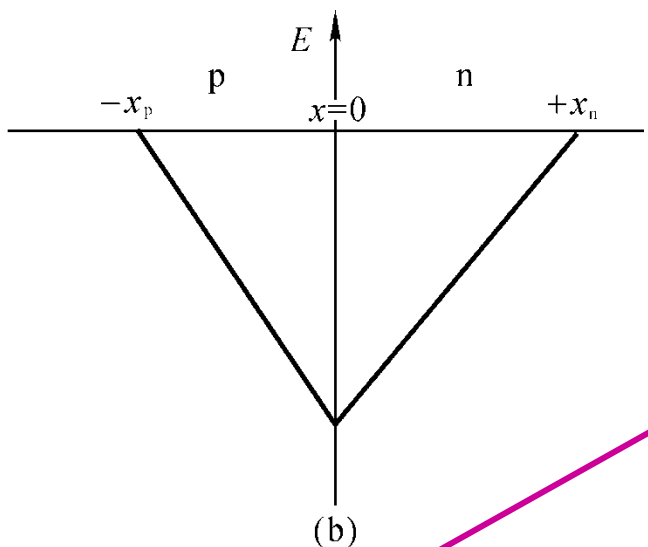
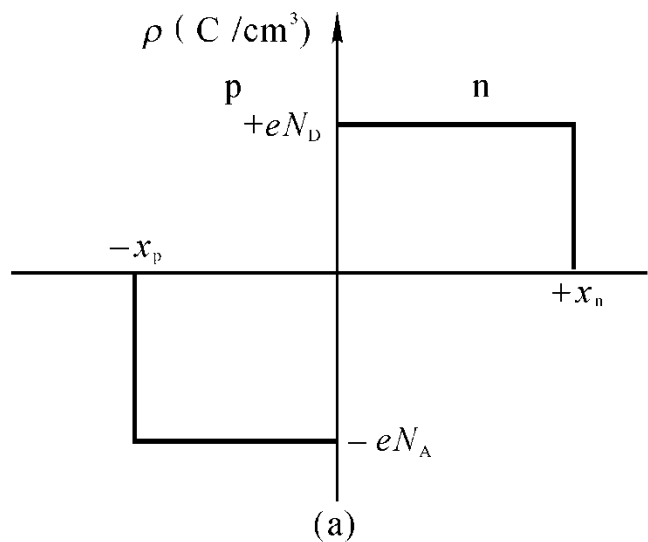
x_n 位置的势垒总高度为

$$V_D = \frac{e(N_A x_p^2 + N_D x_n^2)}{2\epsilon_r \epsilon_0}$$

空间电荷区宽度 space charge width:

$$X_D = x_n + x_p = \sqrt{V_D \left(\frac{2\epsilon_r \epsilon_0}{e} \right) \left(\frac{N_A + N_D}{N_A N_D} \right)}$$

突变pn结:



同质突变pn结

• 空间电荷区用泊松

(Poisson) 方程

$$\frac{d^2\Phi(x)}{dx^2} = -\frac{\Delta\rho(x)}{\epsilon_r \epsilon_0}$$

• 电中性

空间电荷区宽度space charge width:

$$X_D = x_n + x_p = \sqrt{V_D \left(\frac{2\epsilon_r \epsilon_0}{e} \right) \left(\frac{N_A + N_D}{N_A N_D} \right)}$$

接触电位差:

$$V_D = \frac{e(N_A x_p^2 + N_D x_n^2)}{2\epsilon_r \epsilon_0}$$

